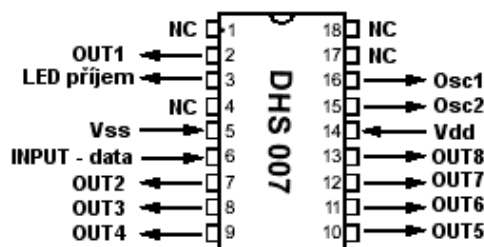


Čip DHS007 je určen k dekódování vstupní informace, přivedené z přijímače / demodulátoru typu SFH506/36 případně SFH 5110/36 apod. Po přijetí informace je po jejím vyhodnocení sepnuta odpovídající kombinace pinů obvodu. Možná chybovost IR přenosu je ošetřena vícenásobným příjmem stejných dat (dekodér musí přijmout 3x po sobě shodný znak pro správné vyhodnocení a sepnutí výstupu).

Název dekodéru „kombinovaný“ vyplývá z použití. Tato varianta dekodéru umožňuje vyhodnocení 8-bitové kombinace na vstupních pinech vysílače DHS004-C. To znamená, že je možno přenášet 255 různých kombinací na 8 vývodech. Bohužel díky internímu hardwarovému řešení použitého čipu není možno jej provozovat v režimu „sleep“.

V praxi tedy dvojice DHS004-C (vysílač) a DHS007 (přijímač) pracují tak, že nastavená kombinace na vstupních pinech kodéru je zrcadlena na výstupních pinech dekodéru. V případě kombinace 0 (na všech pinech vysílače je logická úroveň H, popřípadě jsou piny nezapojeny) není odesílána žádná hodnota a přijímač má na všech výstupech úroveň log. L.

PDIP, SOIC



Příklad: Piny Vstup 0, 3, 4, a 7 vysílače DHS004-C jsou uzemněny (v log. úrovni L) - pak budou na výstupech přijímače piny Výstup 0, 3, 4 a 7 v úrovni logické H.

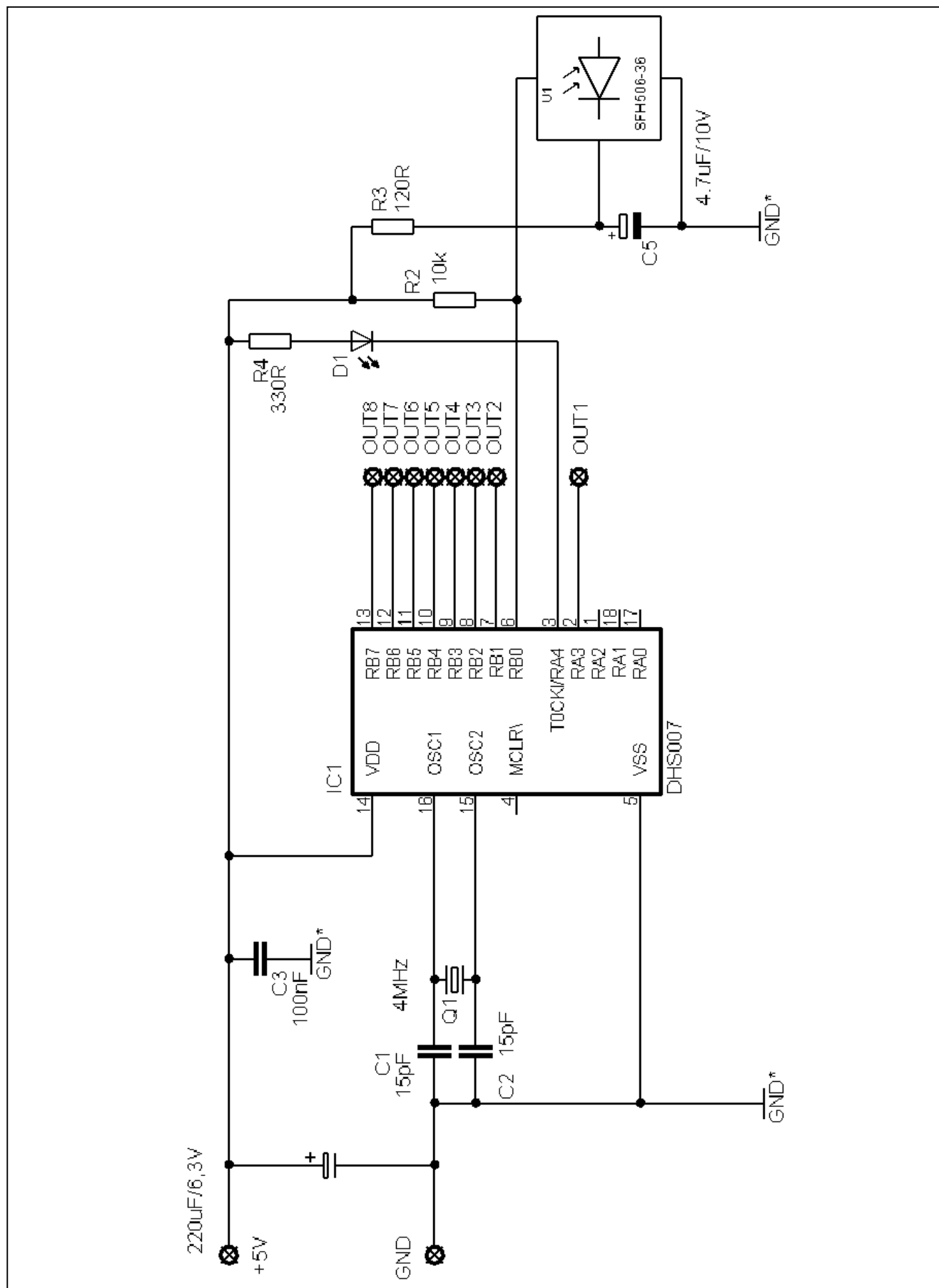
Piny Osc1 a Osc2 jsou opět určeny k připojení externího krystalu s hodnotou 4MHz pro dosažení nutné přesnosti.

Pin číslo 3 (LED – příjem) slouží pro indikaci přijetí povelu. Při úspěšném přijetí povelu je „stažen“ do úrovně GND. POZOR – tento výstup je s otevřeným kolektorem ! Je tedy nutno na tuto skutečnost pamatovat při návrhu externí indikace. Pin je tedy buď v úrovni vysoké impedance, nebo spojen (během signalizace) s úrovní GND.

Použití této součástky: možnost ovládání jednoduchých modelů – využití současného řízení několika výstupů současně.

Napájecí napětí	3 až 5,5 V
Napájecí proud s přijímačem SFH506 bez aktivovaného výstupu	cca 1,9 mA
Napájecí proud pouze přijímače	cca 0,8 mA
Pouzdro	DIP18, SOIC 18

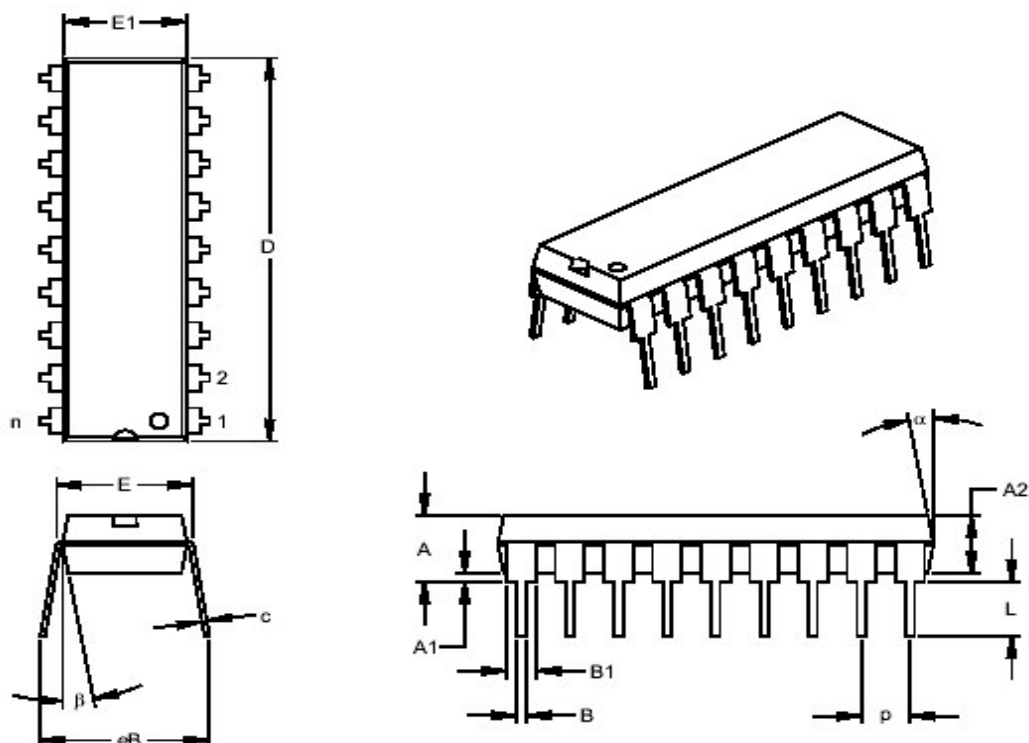
Více informací o vlastních dynamických parametrech součástek DHS006 naleznete v datasheetech firmy MICROCHIP k procesoru 16F628A.

Testované a doporučené schéma zapojení

Pouzdra

Pouzdra obvodů dekodérů DHS006 – A až C jsou pro konstruktéry volitelná buď DIP18 (označení P) nebo SOIC18 (označení SO). Typ pouzdra uvádějte za lomítkem za prefixem součástky (např. pro DIP 18 – DHS006-A/P , nebo pro SOIC 18 - DHS006-A/SO).

Popis a vzorové schéma vysílačů pro tyto dekodéry naleznete v dokumentech součástek DHS004.

K04-007 18-Lead Plastic Dual In-line (P) – 300 mil

Units		INCHES*			MILLIMETERS		
Dimension Limits		MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
Number of Pins	n		18			18	
Pitch	p		.100			2.54	
Top to Seating Plane	A	.140	.155	.170	3.56	3.94	4.32
Molded Package Thickness	A2	.115	.130	.145	2.92	3.30	3.68
Base to Seating Plane	A1	.015			0.38		
Shoulder to Shoulder Width	E	.300	.313	.325	7.62	7.94	8.26
Molded Package Width	E1	.240	.250	.260	6.10	6.35	6.60
Overall Length	D	.890	.898	.905	22.61	22.80	22.99
Tip to Seating Plane	L	.125	.130	.135	3.18	3.30	3.43
Lead Thickness	c	.008	.012	.015	0.20	0.29	0.38
Upper Lead Width	B1	.045	.058	.070	1.14	1.46	1.78
Lower Lead Width	B	.014	.018	.022	0.36	0.46	0.56
Overall Row Spacing	§ eB	.310	.370	.430	7.87	9.40	10.92
Mold Draft Angle Top	α	5	10	15	5	10	15
Mold Draft Angle Bottom	β	5	10	15	5	10	15

* Controlling Parameter

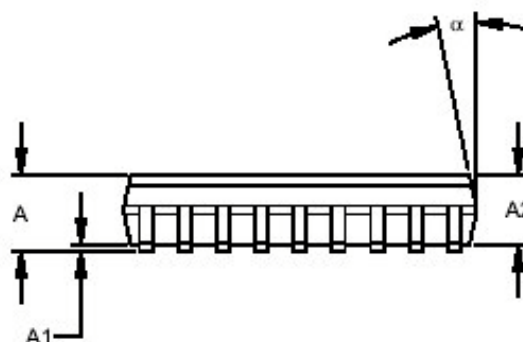
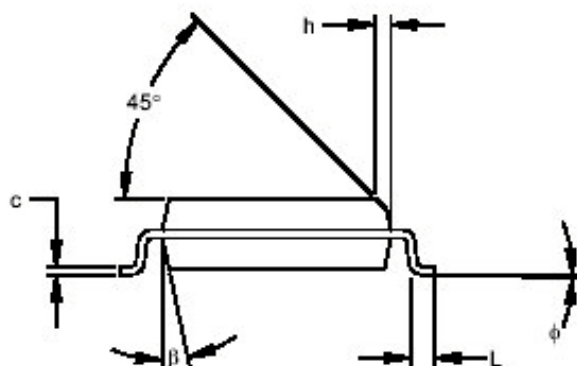
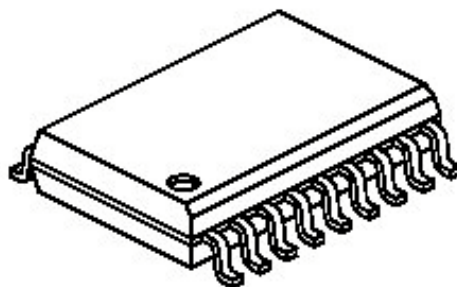
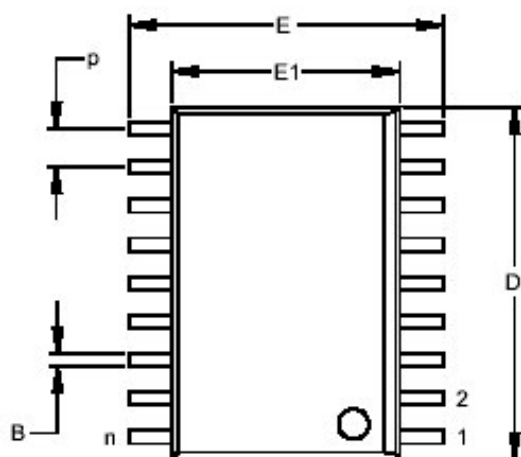
§ Significant Characteristic

Notes:

Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not exceed .010" (0.254mm) per side.

JEDEC Equivalent: MS-001

Drawing No. C04-007

K04-051 18-Lead Plastic Small Outline (SO) – Wide, 300 mil

Units		INCHES*			MILLIMETERS		
Dimension Limits		MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
Number of Pins	n		18			18	
Pitch	p		.050			1.27	
Overall Height	A	.093	.099	.104	2.36	2.50	2.64
Molded Package Thickness	A2	.088	.091	.094	2.24	2.31	2.39
Standoff §	A1	.004	.008	.012	0.10	0.20	0.30
Overall Width	E	.394	.407	.420	10.01	10.34	10.67
Molded Package Width	E1	.291	.295	.299	7.39	7.49	7.59
Overall Length	D	.446	.454	.462	11.33	11.53	11.73
Chamfer Distance	h	.010	.020	.029	0.25	0.50	0.74
Foot Length	L	.016	.033	.050	0.41	0.84	1.27
Foot Angle	φ	0	4	8	0	4	8
Lead Thickness	c	.009	.011	.012	0.23	0.27	0.30
Lead Width	B	.014	.017	.020	0.36	0.42	0.51
Mold Draft Angle Top	α	0	12	15	0	12	15
Mold Draft Angle Bottom	β	0	12	15	0	12	15

* Controlling Parameter

§ Significant Characteristic

Notes:

Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not exceed .010" (0.254mm) per side.

JEDEC Equivalent: MS-013

Drawing No. C04-051